

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】令和6年2月22日(2024.2.22)

【国際公開番号】WO2023/176376
 【出願番号】特願2023-556514(P2023-556514)
 【国際特許分類】

H 0 5 K 1 / 0 9 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 5 K 1 / 0 3 (2 0 0 6 . 0 1)

【 F I 】

H 0 5 K 1 / 0 9 C

H 0 5 K 1 / 0 3 6 1 0 E

H 0 5 K 1 / 0 3 6 3 0 H

10

【手続補正書】

【提出日】令和5年9月13日(2023.9.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

セラミック板と、

前記セラミック板の主面に設けられた第1回路部と、

所定方向に沿って前記第1回路部との間に間隔を空けた状態で、前記主面に設けられた第2回路部と、を備え、

前記第1回路部は、前記主面に設けられた接合体と、前記接合体を介して前記主面に接合された金属体と、前記金属体の表面及び前記接合体のうちの前記金属体からはみ出す部分を覆うように形成された金属被膜と、を有し、

30

前記接合体は、前記金属体に接合され、銀の含有量が50質量%以上である銀接合層を含み、

前記金属被膜は、前記銀接合層のうちの前記第2回路部に対向する側面を覆うように形成された側方部分を含み、

前記側方部分の前記第2回路部に近い端部と、前記銀接合層の前記第2回路部に近い端部との間の前記所定方向における距離Lは、前記金属被膜の厚さHよりも大きく、

前記距離Lは2μmよりも大きく、且つ、20μm以下であり、

前記第1回路部と前記第2回路部との間の前記所定方向における距離は、0.3mm～1.5mmである、セラミック複合基板。

【請求項2】

40

前記厚さHは2μm以上である、請求項1に記載のセラミック複合基板。

【請求項3】

前記セラミック板は、窒化ケイ素又は窒化アルミニウムを含有し、

前記金属被膜は、ニッケル又は金を含有する、請求項1又は2に記載のセラミック複合基板。

【請求項4】

請求項1又は2に記載のセラミック複合基板を製造する方法であって、

前記接合体及び前記金属体を形成するようにエッチングを行う工程と、

前記金属被膜を形成する工程と、を含む、セラミック複合基板の製造方法。

50